
金融危机下的MCU发展趋势

何小庆

北京麦克泰软件技术公司董事长

2009年3月28日北京

嵌入式系统联谊会

<http://www.esbf.org.cn>

简要纲要

- 半导体和MCU 市场现状
- 三大MCU 技术走向
- 三大MCU 市场走向
- 结束语

半导体和MCU 市场现状

- 赛迪数据显示2008年中国MCU市场的增长只有5.8%
- NXP除了裁员和关闭制造工厂外，还传出可能被兼并的消息。
- 飞思卡尔CEO Rich buyer最近在接受EE-Times专访时表示将专注在汽车电子和通讯领域，其无线IC业务将被整个或者部分出售。
- Atmel最近公布了2008年第三季度净亏损为470万美元。公司董事会拒绝了Microchip和ON Semi近期主动提出的以23亿美元现金**收购**的提议
- 中国本土550家芯片设计公司正在面临重新的整合

三大MCU 技术走向

- 单一架构体系MCU优势逐现
 - 市场迹象表明中高端MCU在向着ARM, X86 SoC主流计算平台的方向发展
- 低功耗MCU成为新宠
 - 低功耗设计是一个系统课题，需要多学科多环节共同解决
- 面向应用的高集成度MCU
 - 人机界面技术和MCU的结合越来越多
 - 无线和有线的通信方式和MCU结合越发紧密

三大MCU市场走向

■ 汽车电子应用

- 汽车电子需要厚积而薄发
- 国产汽车电子软件得到‘核高基’支持。

■ 工业控制应用

- 国家4万亿重点项目支持
- 工业控制涉及从MCU、MCU/MPU模块到EPC系统

■ 小家电应用

国产MCU广泛的应用舞台

结束语

- 传统MCU的定义变得模糊
 - 8-16-32位概念正在改变
 - 通用性在向着面向应用的SoC演进
 - 标准化是MCU发展的障碍之一
- MCU将不断领导电子产品创新
 - 嵌入式软件在其中起主导作用
 - IP软化和嵌入式软件硬化将交织和融合
 - 金融危机催生了低价值电子产品升级
 - 金融危机让高价格电子产品平民化

謝謝

THANK YOU

联络 : allan.he@bmrtech.com
